

第26回 有機/無機接合研究委員会

日時：2025年10月20日（月）13:00～16:00

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 荘司 郁夫（群馬大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『光応答性表面処理材料の開発と新たな微細配線形成技術への応用』（40分）

..... ○川上 雄介（(株)ニコン）

13:50～14:30

『生体模倣システムにおける接合と配線』（40分）

..... ○高田 裕司（群馬大学）

14:30～14:40 休憩

司会 朝桐 智（(株)東芝）

14:40～15:20

『熱水処理による金属表面ナノ構造を利用した金属樹脂直接接合』（40分）

..... ○梶原 優介、木村 文信（東京大学）

15:20～16:00

『マルチマテリアル接着接合における接着強度に関する機械学習を活用した予測手法の開発』（40分）

..... ○浅利 裕介^{*1}、田中 慎吾^{*1}、鈴木 智久^{*1}、近藤 剛資^{*1}、武田 新太郎^{*2}、永田 睦美^{*2}

(^{*1}(株)日立製作所、^{*2}(株)日立ハイテク)

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会